

# PALTEK

(証券コード:7587)

## 2019年12月期 決算説明資料

2020.2.12 (水)

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.



### 本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

- ① 2019年12月期 業績結果
- ② 2020年12月期 業績予想
- ③ 今後に向けた取り組み
- ④ 中期経営計画について

1

## 2019年12月期 業績結果

## 2019年12月期 業績結果 サマリ

### ■ 売上高は微減

- 半導体事業は減少するが、デザインサービス事業、ソリューション事業が増加し、微減にとどまる

### ■ 営業利益・経常利益は販管費増、為替変動の影響で減少

- デザインサービス事業、ソリューション事業の売上増で収益性改善するも、新規事業への投資で販管費増
- 為替は円高基調であったため、マイナスの影響

### ■ 今後の成長に向けた新たな取り組みを加速

- モビリティビジネスの新規立ち上げ
- AIソリューションでのパートナー連携の加速
- ソリューション事業でのプロモーション強化

(百万円)	2018年12月期		2019年12月期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
売上高	30,569	100.0%	30,401	100.0%	△167	△0.5%
売上総利益	3,700	12.1%	3,734	12.3%	33	0.9%
販管費	3,142	10.3%	3,319	10.9%	177	5.7%
営業利益	558	1.8%	414	1.4%	△144	△25.8%
経常利益	299	1.0%	284	0.9%	△14	△4.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	185	0.6%	123	0.4%	△62	△33.4%
1株当たり当期純利益	16.97円	-	11.30円	-	△5.66円	△33.4%

#### 主な増減要因

- 営業利益率の減少は、新規事業への投資などによる販管費増加のため
- 経常利益の減少は、営業外費用として為替差損などが発生したため
- 親会社株主に帰属する当期純利益の減少は、特別損失として投資有価証券評価損および和解金を計上したため

(百万円)	2018年12月期		2019年12月期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
半 導 体	28,536	93.3%	27,464	90.3%	△1,071	△3.8%
デザインサービス	1,799	5.9%	2,218	7.3%	418	23.3%
ソリューション	233	0.8%	718	2.4%	485	207.9%
売上高合計	30,569	100.0%	30,401	100.0%	△167	△0.5%

### 主な増減要因

- 半導体事業は、医療機器や計測機器向けなどにFPGAが増加した一方で、海外の携帯情報端末向けメモリ製品が大幅に減少したことなどを受け減少
- デザインサービス事業は、産業機器、航空/宇宙分野向けなどが増加
- ソリューション事業は、映像配信システムおよび産業向けIoTシステムの販売が増加

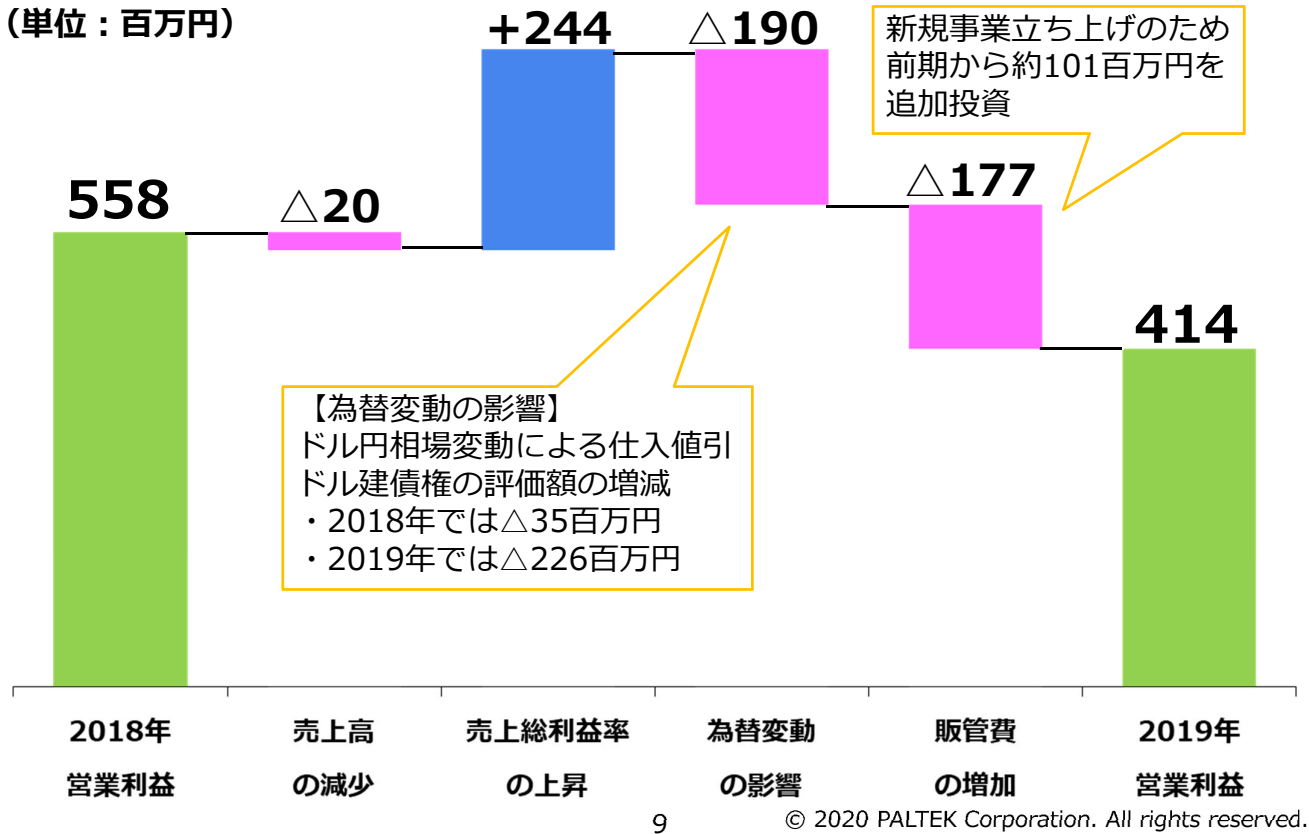
## ■ 売上総利益率の上昇は、以下の2つが要因

- デザインサービス事業およびソリューション事業の売上増、利益率の低い携帯情報端末向けの売上減により、売上総利益率が上昇
- ドル円相場により変動する仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額の増減等により売上総利益が、  
2018年では △35百万円 (△0.1%分)  
2019年では △226百万円 (△0.7%分) の影響があったこと

(百万円)	2018年12月期		2019年12月期	
	金額	対売上比率	金額	対売上比率
売上総利益	3,700	12.1%	3,734	12.3%
(うち為替の影響額)	△35	△0.1%	△226	△0.7%
売上総利益 (為替の影響を排除)	3,736	12.2%	3,960	13.0%

## 営業利益の増減分析

(単位：百万円)

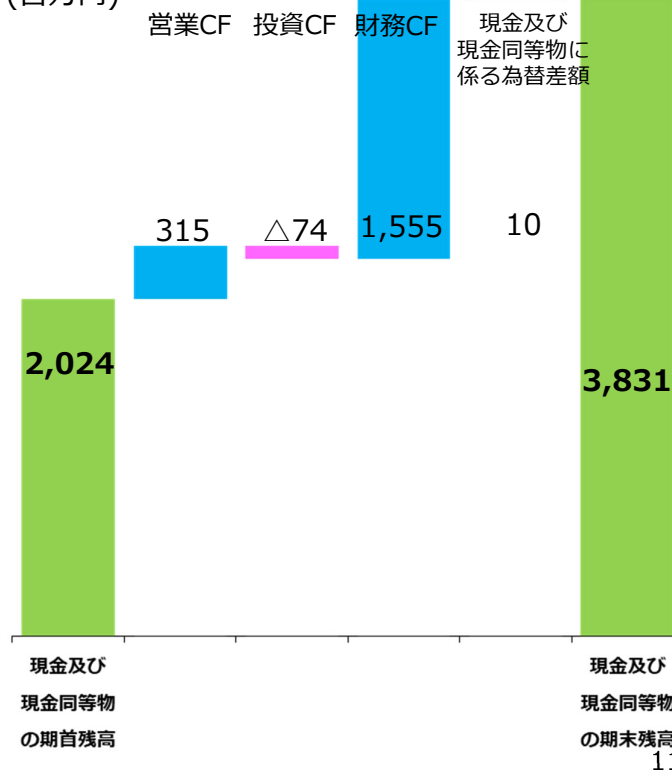


## 連結貸借対照表の状況

	(百万円)	2018.12	2019.12	増減額	主な増減理由
資産内訳	現金及び預金	2,024	3,831	1,807	借入れ実施により増加
	売上債権	6,354	6,589	235	
	商品	3,126	2,945	△180	
	その他流動資産	1,774	2,177	402	未収消費税等が増加
	固定資産	567	555	△11	
資産合計		13,846	16,099	2,252	
負債純資産内訳	仕入債務	945	863	△82	
	短期借入金	2,010	3,680	1,670	借入れを実施
	その他流動負債	1,091	1,780	689	未払金が増加
	固定負債	256	219	△37	
	純資産	9,542	9,556	13	
負債・純資産合計		13,846	16,099	2,252	

# 連結キャッシュ・フローの状況

2019年12月期のキャッシュフローの動き  
(百万円)



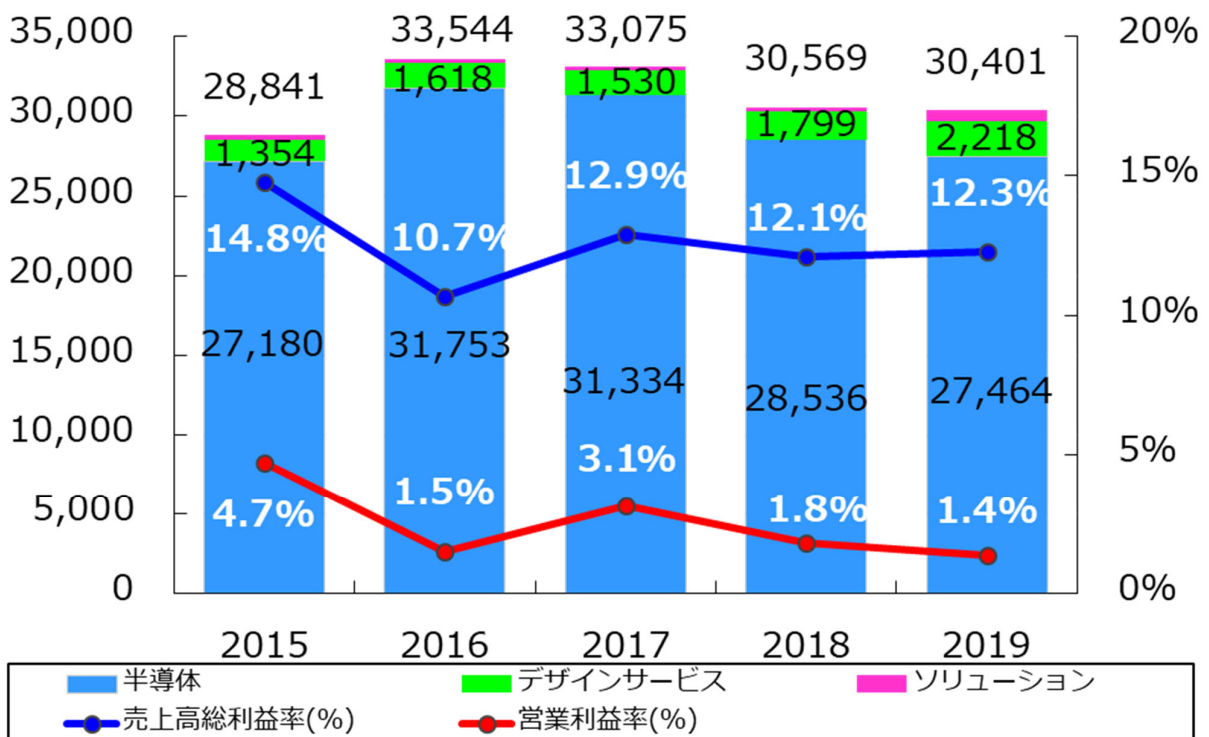
(百万円)	2018年 12月期	2019年 12月期
現金及び現金同等物の期首残高	2,178	2,024
営業CF	3,109	315
投資CF	△61	△74
財務CF	△3,177	1,555
現金及び現金同等物の期末残高	2,024	3,831

2019年12月期のキャッシュフローの動き

- 【営業CF】 売上債権が増加した一方で、税金等調整前当期純利益の計上、及びたな卸資産、未収入金の減少等により収入
- 【投資CF】 有形固定資産および無形固定資産の取得等により支出
- 【財務CF】 配当金支払い実施の一方で、借入れの実施により支出

# 連結業績推移

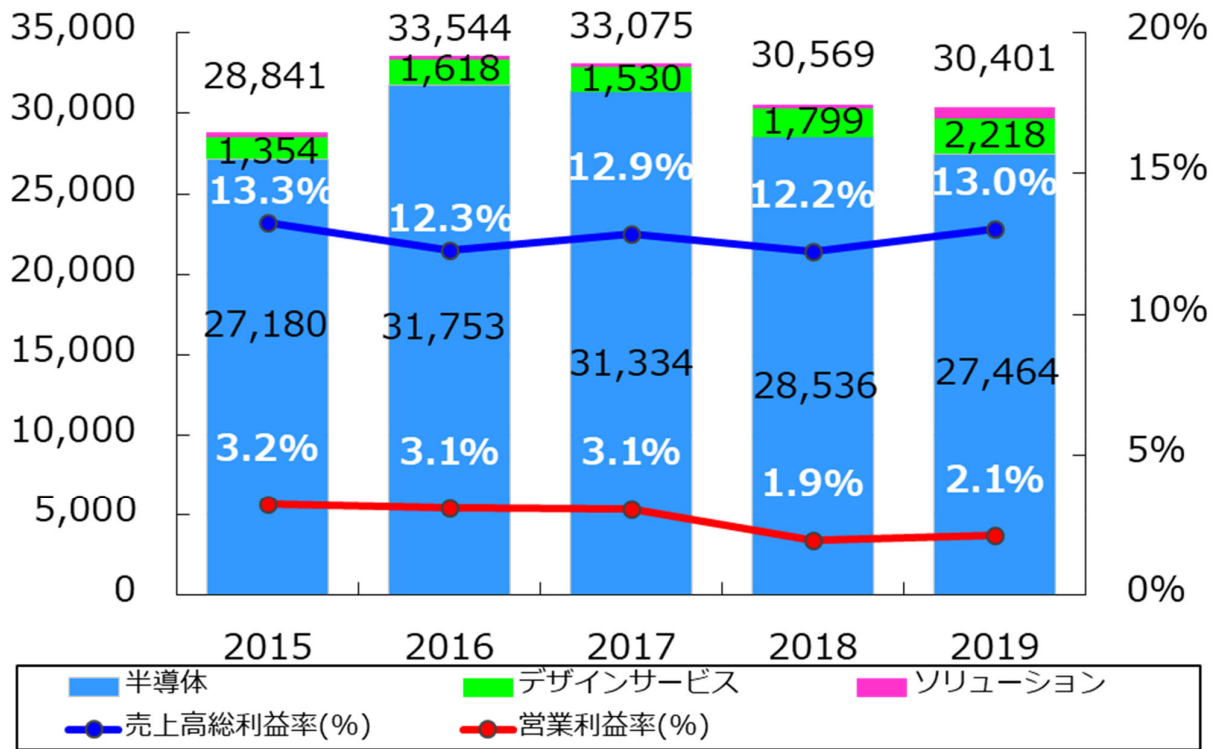
(百万円)





# 連結業績推移（為替影響を排除）

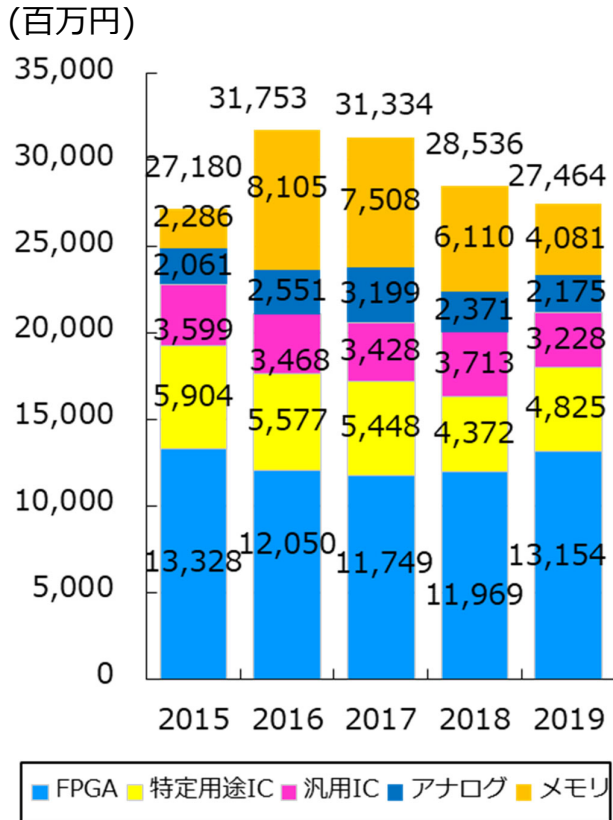
(百万円)



SOLUTION SUPPLIER  
**PALTEK**

## 事業別の実績

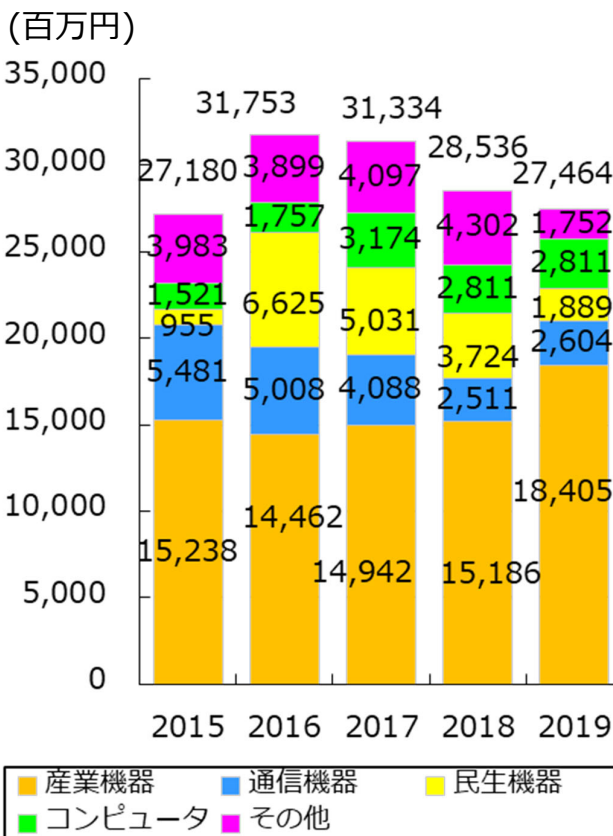
## 半導体事業の状況（製品別）



### 業績の推移

- FPGA**  
医療機器、計測機器、放送機器向けなどが増加
- 特定用途IC**  
通信機器向け、PC向けタッチパッドが増加
- 汎用IC**  
ファクトリーオートメーション向けなどが減少
- アナログ**  
スーパーコンピュータ向けなどが減少
- メモリ**  
海外の携帯情報端末向けが減少

## 半導体事業の状況（用途別）



### 業績の推移

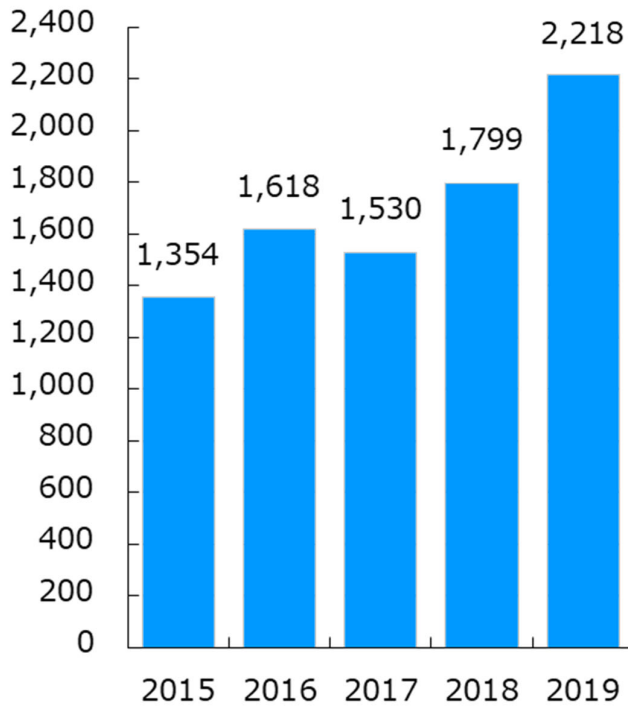
- 産業機器**  
医療機器、放送機器、計測機器、航空/宇宙向けなどが増加
- 通信機器**  
通信インフラ向けが増加
- 民生機器**  
海外の携帯情報端末向けが減少
- コンピュータ**  
スーパーコンピュータ向けが減少するも、PC向けが増加





## デザインサービス事業の状況

(百万円)



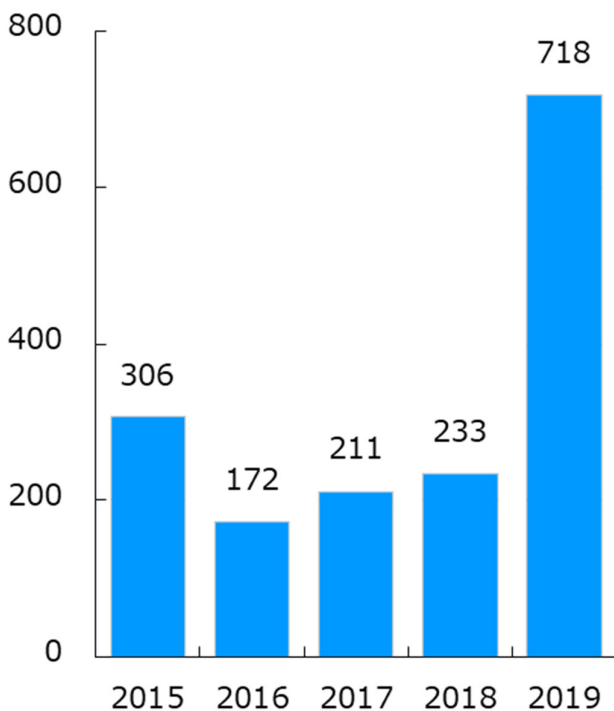
### 業績の推移

- 公共インフラ、医療機器、航空/宇宙向け増加
- ODMの比率は64%



## ソリューション事業の状況

(百万円)



### 業績の推移

- 産業向けIoTシステム、航空/宇宙向け映像配信システムが増加

2

## 2020年12月期 業績予想

## 業績見通しの前提条件

### ■ エレクトロニクス業界と取り巻く事業環境

- 米中貿易摩擦の継続、新型コロナウイルス感染症の影響で不透明感あり

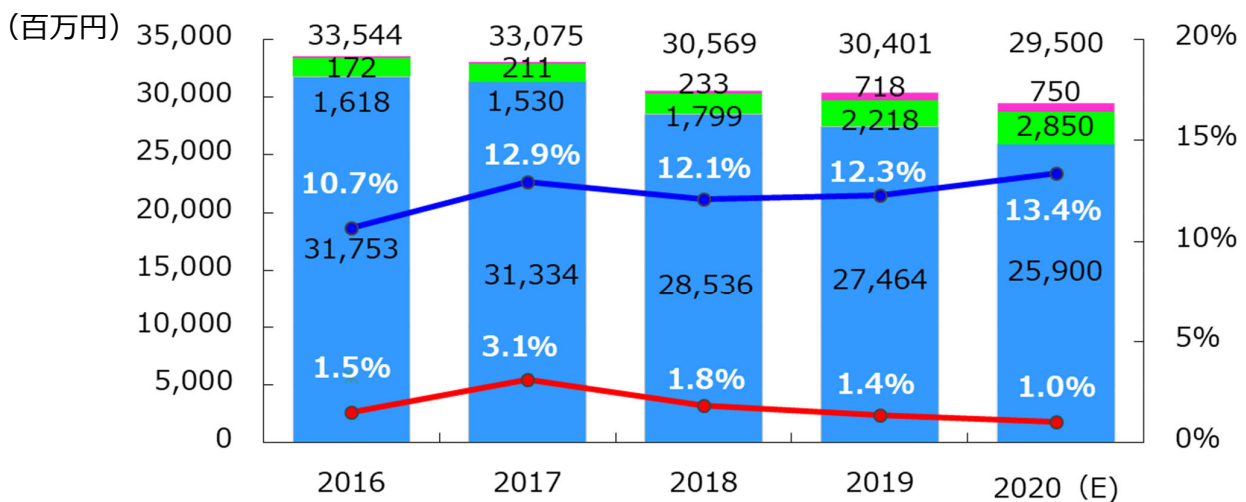
### ■ 主要仕入先ガイリンクス社との取引形態変更の影響

- 取引先の他社への移管により、FPGAビジネスは前期から減少

### ■ 将来に向けた新たな取り組みによる先行投資を継続

- モビリティビジネス、AIソリューション、その他ソリューション事業などが先行投資期間

(百万円)	2019年12月期 実績			2020年12月期 予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	14,794	15,607	30,401	14,000	15,500	29,500	△902	△3.0%
売上総利益	1,703	2,031	3,734	1,850	2,100	3,950	215	5.8%
売上総利益率	11.5%	13.0%	12.3%	13.2%	13.5%	13.4%	-	-
販管費	1,641	1,678	3,319	1,800	1,850	3,650	330	9.9%
営業利益	61	362	414	50	250	300	△114	△27.6%
営業利益率	0.4%	2.3%	1.4%	0.4%	1.6%	1.0%	-	-
経常利益	62	222	284	10	210	220	△64	△22.7%
当期純利益	23	100	123	7	143	150	26	21.2%



- 売上高 : デザインサービス事業が増加するものの、半導体事業が減少
- 売上総利益率 : 利益率の高いデザインサービス事業の売上高が増加するため上昇
- 営業利益率 : モビリティビジネス、AIソリューションなどの新規事業への人材投資を継続するため販売費及び一般管理費が増加し、営業利益率は低下

## 株主還元方針および1株当たり配当金

- 利益配分については、経営基盤の強化や将来の事業展開を考慮し、適正に配分。株主の皆様へは、配当金にて還元いたします
- 配当金については、安定的な配当を維持しながら、業績に対する配当性向を勘案
- 2020年12月期配当金は、1株あたり10円を予定

## 配当金の推移

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年(予)
1株当たり配当金	8円	15円(※)	13円	13円	10円	10円	10円
配当性向(連結)	16.2%	24.4%	1,238.7%	20.3%	58.9%	88.5%	73.0%
当期純利益(百万円)	563	674	11	703	185	123	150

※ 普通配：12円、記念配：3円

23

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

## 株主優待制度

### ■ 対象となる株主様

- ・ 毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株以上を保有している株主様

### ■ 株主優待の内容

- ・ 毎年12月31日現在の保有株式数と継続保有期間に応じて、優待品(クオカード)を年1回贈呈



保有株式数	継続保有期間	
	3年未満	3年以上
100株以上～500株未満	クオカード500円分	クオカード1,000円分
500株以上～1,000株未満	クオカード1,000円分	クオカード2,000円分
1,000株以上	クオカード2,000円分	クオカード3,000円分

# 3

## 今後に向けた取り組み

## PALTEKの方向性

### ■ 経営方針

- ・ ソリューションサプライヤーとして社会的意義ある価値を創出し、ニーズとシーズを照らし合わせた、付加価値の高い製品提案、ソリューションの開発
- ・ 収益性の高い経営を目指す

### ■ 各事業の方向性

#### ソリューション事業

基軸事業を活用し、市場ニーズに合ったソリューションを提供する事業

#### デザインサービス事業

半導体事業で積み重ねた強味を活かし、常に新しい技術を活用した開発力と設計品質の向上に努め、付加価値を高める事業

#### 半導体事業

成長市場に注力し、安定的に収益を上げていく基盤事業



# PALTEKグループの強み



半導体をベースにした営業力・提案力・開発力



無線通信技術



画像処理技術



制御技術



センサ技術

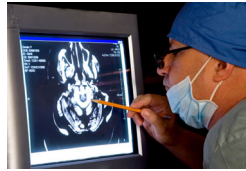


注力技術

5G、AI、IoT、ADAS、ロボット、データセンター



産業機器



医療



放送・映像



公共インフラ



車載



# 各事業の位置づけ

基軸事業	半導体事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>産業分野、通信分野などを中心に半導体関連製品を提供</li> <li>AI活用分野や、IoT、データセンター、車載周辺市場などへの提案力を強化</li> </ul>
	デザインサービス事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>培ってきた技術力、設計力をベースに設計受託、ODMを行い、収益性を高める</li> </ul>
新規事業 (投資フェーズ)	デザインサービス事業 (モビリティビジネス)	<ul style="list-style-type: none"> <li>モデルベース開発により車載分野での設計受託案件を拡大し、成長分野で収益性を高める</li> </ul>
	ソリューション事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>基軸事業を活用し、社会的ニーズに合ったソリューションを提供し、収益性を高める</li> </ul>

## 【半導体事業【基軸】】 重点施策について

### 【事業環境】

- 5G、IoT、ビッグデータ、AIの活用により半導体市場が拡大
  - ネットワークの高速化に伴いエッジコンピューティングなどの活用が見込まれる
- 車載分野およびその関連市場の半導体市場拡大へ

### 取り組み

- 5G、IoT、データセンター、エッジコンピューティング、AI使用関連市場に注力
  - ⇒ FPGA、メモリ、マイコン、電源などビジネス拡大
- ソリューション提案（新たな市場へ展開）  
（例：エッジコンピューティング+AI..etc）

## FPGAビジネスについて

### 【FPGA市場動向】

- 5G、データセンター、エッジコンピューティング、AI向けにさらにニーズが高まる
  - ネットワークの高速化に伴い、FPGAを活用した高速処理が必要
- ザイリンクス社では、クラウドからエッジまであらゆるアプリケーションに対応する製品を市場投入
  - 5Gによる高速化に対応した高速演算エンジン、次世代インタフェースを搭載
  - AIエンジンでAI推論と無線通信を高速化



プライム/AIコア シリーズ

### 取り組み

- 新製品のプロモーション強化
- 既存顧客への技術サポート強化
- 技術サポートからの技術提案力

## 既存市場

- FA・ロボット
- 医療機器
- 放送機器
- 計測機器
- 通信機器



## FPGAの新規市場

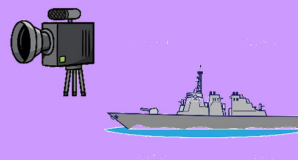
【AI/IoT】  
農業、工場、小売、建機



【金融】  
銀行、証券会社



【ビデオ】  
動画配信、OTT、防衛

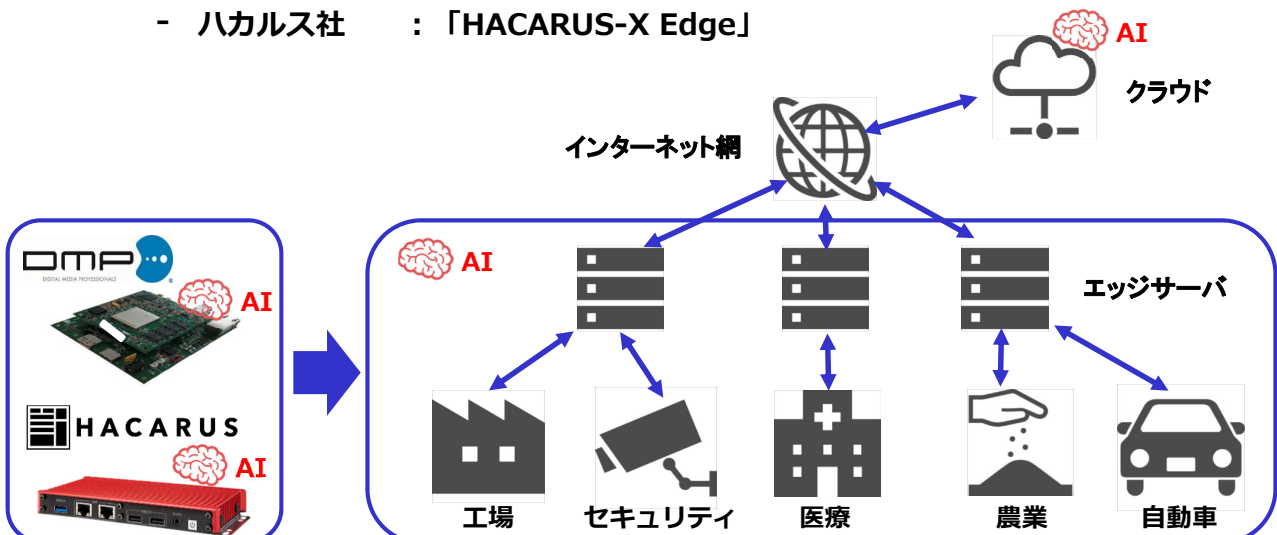


【物流】  
通信販売、食品/製薬  
観光業、バス/トラック



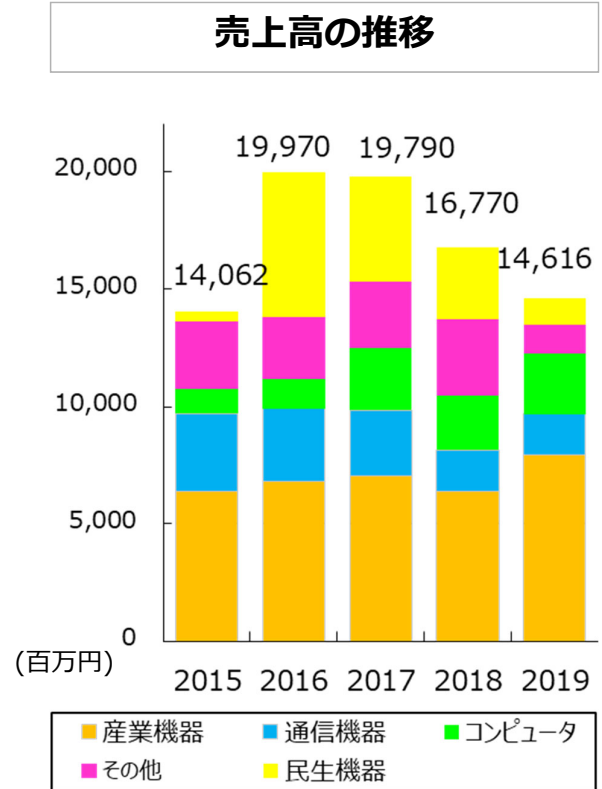
## ■ エッジ向けAIソリューション提案を継続

- エッジコンピューティングでのAI活用では、FPGAが最適
- エッジコンピューティング向けに提供
  - DMP社 : AI FPGA モジュール「ZIA™ C3」
  - ハカルス社 : 「HACARUS-X Edge」





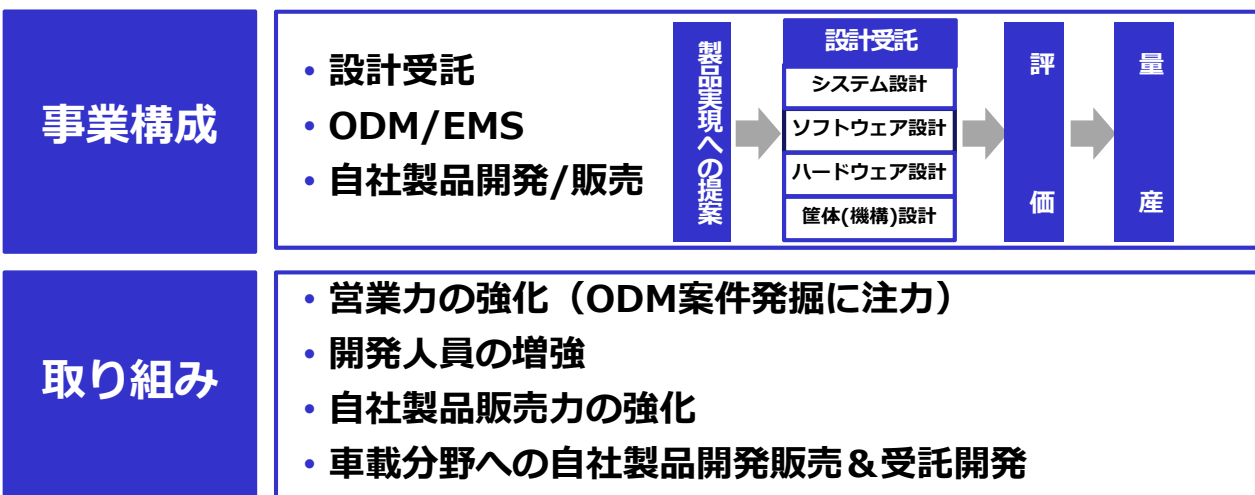
- 産業機器向けはゆるやかに増加傾向
- 成長市場へ新規案件活動継続
  - 5G
  - IoT/データセンター/クラウド
  - 産業機器



## 【デザインサービス事業 [基軸] ・ [新規] 】 重点施策について

### 【事業環境】

- 機器自体やそれを構成する半導体などが高機能化・高度化し、すべてをお客様のみで開発することが困難
- お客様は社外リソースも活用し、製品リリースの早期化が必要



## ■ 事業の状況

- 産業機器、医療機器が堅調

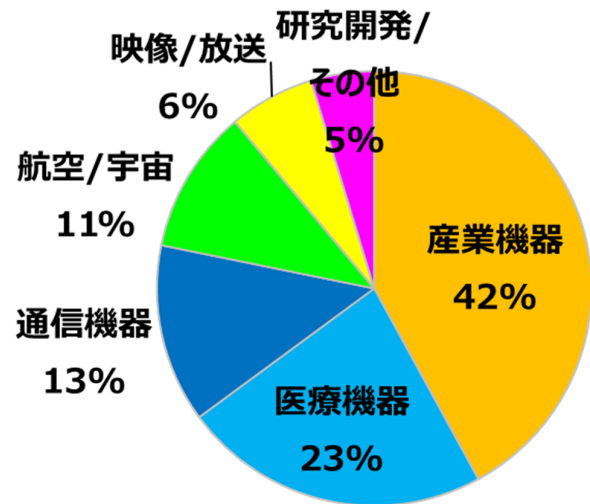
用途別売上構成（2019年）

## ■ 設計受託・ODMの今後の展開

- 5G、AI、IoTなどの新技術を活用した案件獲得に注力

## ■ グループ会社での事業展開

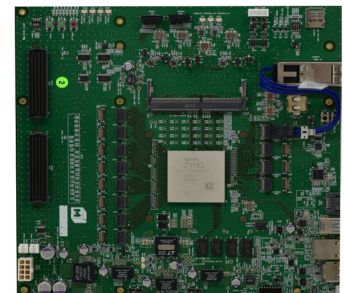
- エクスプローラ
  - 受託・ODM・自社製品販売強化
- テクノロジーイノベーション
  - センサー開発・営業力強化
- ウィビコム
  - 受託開発継続獲得へ



## ■ FPGAコンピューティングプラットフォーム「M-CUBE」を開発中

### ■ 高速演算処理が必要な開発向け

- エッジコンピューティングの高速化
- 4K/8Kなどのビデオ処理
- 機械学習、ビッグデータ分析など



M-CUBE

### ■ 受託開発やODM獲得を目指す

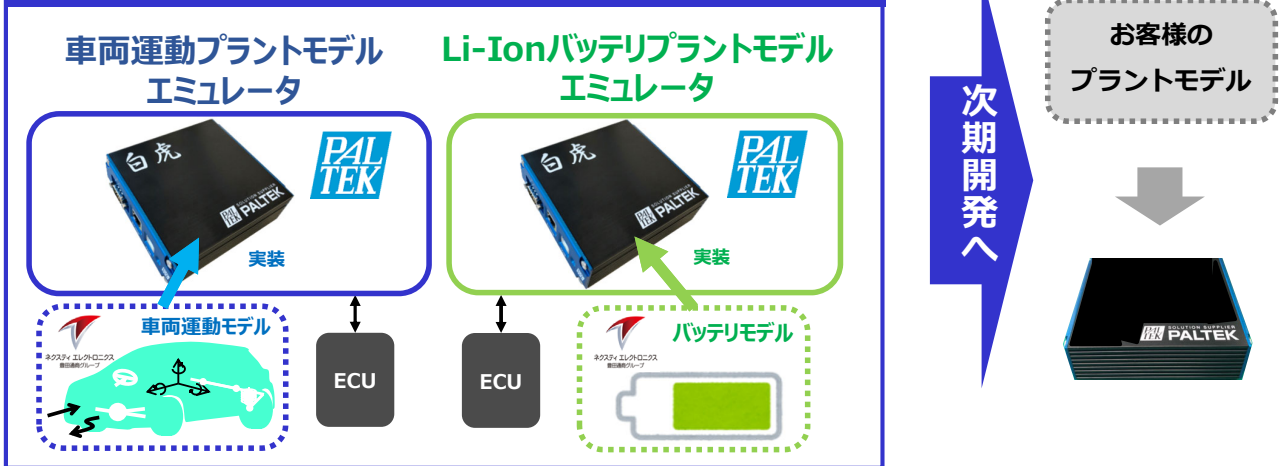
#### 【M-CUBE の主な特徴】

- ザイリンクス社のMPSoCの大規模デバイスを搭載
- M-CUBEを複数連結可能で、大規模システムのニーズを満たす
  - ・スーパーコンピュータに使用する100GEthernetや100Gスイッチ接続可能
  - ・PALTEK製8K画像処理ボードにも接続可能
- 高速インタフェースSAMTEC社FireFly™コネクタを搭載

## ■ ハードウェアエミュレータ「白虎」の開発/販売

- ・ 車両運動モデル、バッテリーモデルを販売
- ・ PALTEKの強みを生かす製品：ソフト ⇒ ハード（高速化）

### 自動運転車・電動化開発用 ハードウェアエミュレータ



## 【ソリューション事業 [新規]】 事業領域の開拓

### ■ ソリューション事業の狙い

- ・ 市場拡大が見込まれる分野に注力したソリューションを発掘・開発
- ・ 将来的にIoTやサービス等の付加価値の可能性のあるソリューションを展開

	産業	映像・放送	医療・介護 ヘルスケア	自動車	物流
既存顧客	工場向け 監視 システム	映像配信 システム	作業支援 アシスト スーツ		紙資材 梱包 システム
新規顧客			乳幼児 見守り システム	TPMS 運行管理 システム	作業支援 アシスト スーツ

要素技術は、AI、通信、画像処理、センシング

## ■ 不安定な伝送路でも映像データを伝送できる秘匿性の高い SRT搭載 4K対応 H.265/HEVCコーデックシステムを拡販

<エクスプローラ製品>

- ・ 放送分野、配信業者、産業機器分野など幅広い分野で新規案件獲得へ

<Haivision製品>

- ・ 航空/宇宙分野に注力 営業力強化⇒プロモーション力強化
- ・ 医療分野へ展開 パートナーと連携強化

SRT Open Source

SRTアライアンス：PALTEK、エクスプローラともに参画

⇒ SRTの優位性で日本市場へ展開

エクスプローラ製コーデック



Haivision VIDEO ENCODERS



Makito X Series

## ■ ビジネスの位置づけ

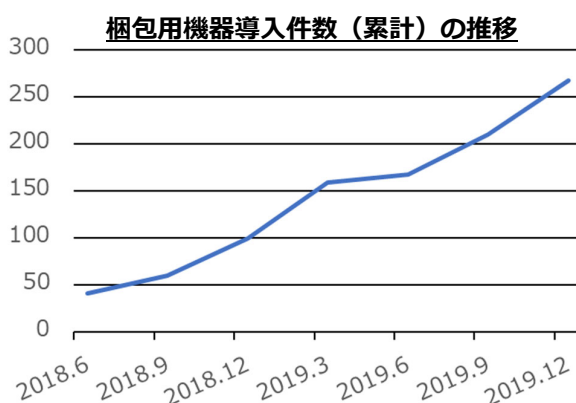
- ・ 成長すると見込まれる物流分野への事業展開
- ・ 生態系への影響懸念により脱プラスチックが進む中、プラスチック系緩衝材に代わる紙緩衝材活用を提案
- ・ ストック型ビジネス



<梱包用機器>

## ■ 展示会等へ出展を継続 認知度を上げて案件獲得継続中

## ■ システム導入件数は順調に増加



<時計・ジュエリー>



<産業機器>



<食料品(冷凍品)>

## ■ ビジネスの位置づけ

- ・ 介護、工場、倉庫、農業分野などでの腰への負担を軽減することで、労働環境の改善を支援



## ■ 「マッスルスーツEvery」を拡販

- ・ 11月に新製品として発売開始。価格は136,000円
- ・ 空気圧式の人造筋肉で電気を使わないため、継続的に使用可能
- ・ 展示会などの積極的に出展

<p>「震災対策技術展」 (2020/2/6~7)</p>	<p>CareTEX (2020/2/12~14)</p>
<p>国際物流総合展 - INNOVATION EXPO - (2020/2/19~22)</p>	<p>建築・建材展 (2020/3/3~6)</p>

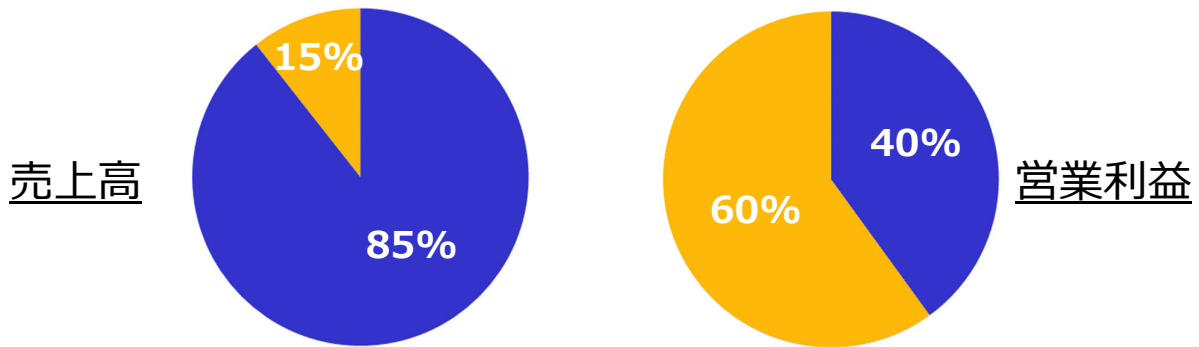
## ■ 利用シーン例



## ■ 数値目標（2022年度）

売上高	400億円以上
営業利益率	5%以上

2022年時の売上高/営業利益の構成イメージ



■ 半導体事業
 ■ デザインサービス事業 + ソリューション事業

## 主な新規事業の収益化へのロードマップ

	2019年	2020年	2021年	2022年
AIソリューションの強化	パートナー拡充 ソリューション構築・展開	ソリューション展開・案件獲得	ソリューション展開・案件獲得	案件獲得の継続
IoTソリューションの強化	プロモーション継続・ソリューションの開拓	案件獲得の継続	案件獲得の継続	案件獲得の継続
ODMビジネスの強化	案件獲得の継続			
モビリティに関するソリューション開発	技術の習得・人材育成 案件獲得	案件獲得の継続	案件獲得の継続	案件獲得の継続
ビデオソリューションの強化	プロモーション継続	案件獲得	案件獲得の継続	
フリートマネジメントビジネスの強化	プロモーション継続	量産案件獲得	量産案件獲得	量産案件の継続
乳幼児見守りシステム、ウェアラブルスーツ販売	新規顧客開拓	新規顧客開拓	新規顧客開拓	新規顧客開拓
紙梱包資材ビジネスの販売強化	新規顧客開拓	新規顧客開拓	新規顧客開拓	新規顧客開拓

投資期

黒字転換期

利益成長期

# 参 考 資 料

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.



## 為替変動に関する影響

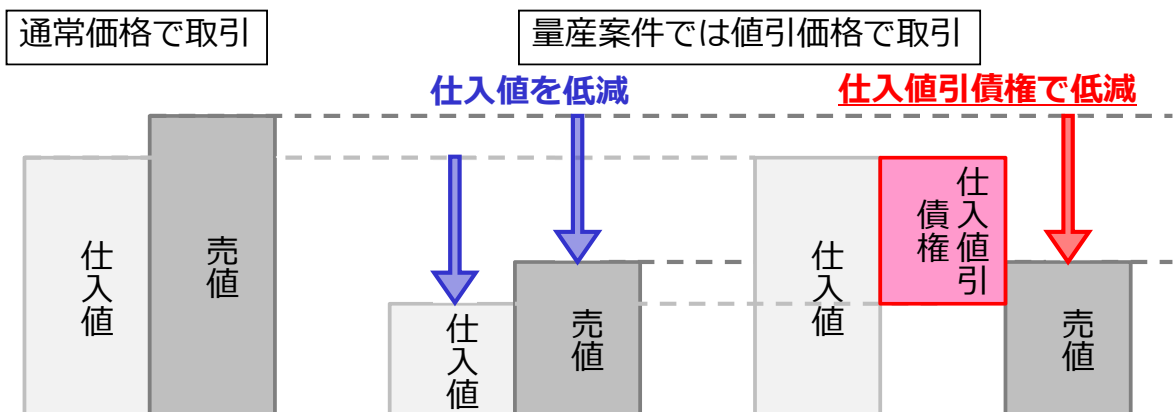
■ 為替変動により当社グループの利益は以下の4点で影響を受ける

- ① 仕入値引ドル建債権の為替変動による影響
- ② 調達在庫の為替変動による影響
- ③ 決済時のドル調達レート変動による影響
- ④ ドル建売掛金入金時のレート変動による影響

## 為替変動による影響の発生要因①

### 【仕入値引ドル建債権の為替変動による影響】

- 当社が仕入先に対して保有する『仕入値引ドル建債権』が、為替レートの変動により評価額が増減することで、業績に大きな影響を与える
- 仕入値引ドル建債権について：
  - ・ 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
  - ・ その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
  - ・ その実現方法は、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」

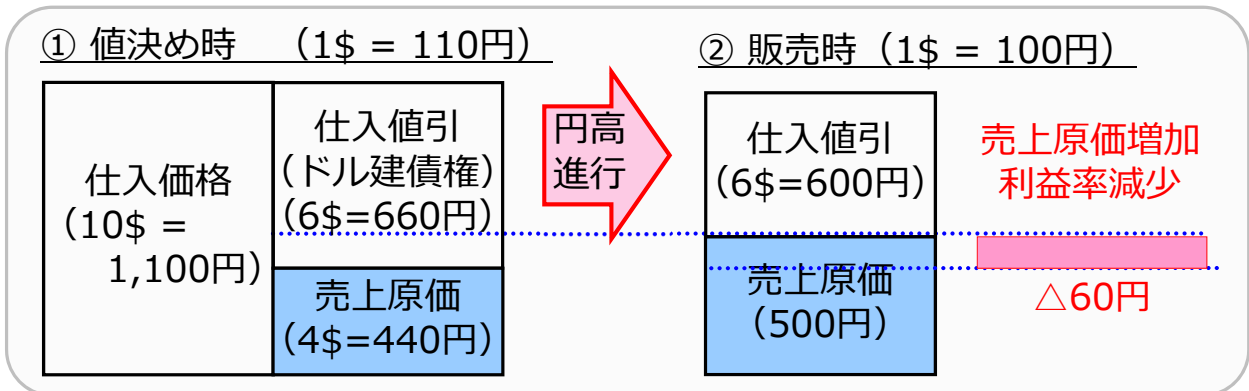




## 急速な円高進行による仕入値引債権の評価額減少

- 仕入値引債権の評価額の増減は、値決め時と販売時の為替レートの差により生じる
- そのため、急速に円高が進行すると、為替レートの差が大きくなるため、仕入値引債権の評価額が大幅に減少
- これにより、売上原価が増加し、売上総利益が減少

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化

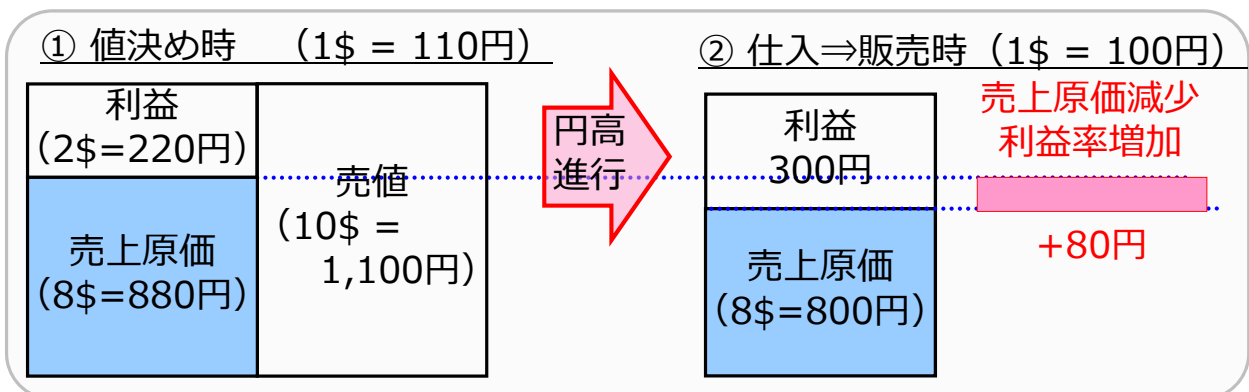


## 為替変動による影響の発生要因②

### 【調達在庫の為替変動による影響】

- 海外から仕入れたドル建の製品において、為替レートが円高に進行することにより、売上原価が減少し、売上総利益は増加

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化

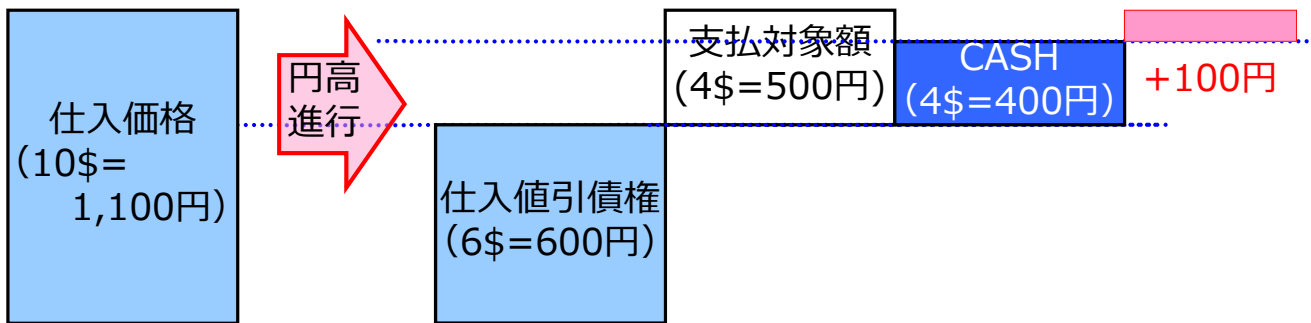


## 為替変動による影響の発生要因③

### 【決済時のドル調達レート変動による影響】

- 支払を行う際に円高に進行していた場合、ドルを調達する金額が少なくなるため、決済差額が生まれ、為替差益を計上することとなる
- 一方、円安に進行した場合は、為替差損を計上することとなる

① 仕入時 (1\$ = 110円) ② 販売・支払時 (1\$ = 100円)



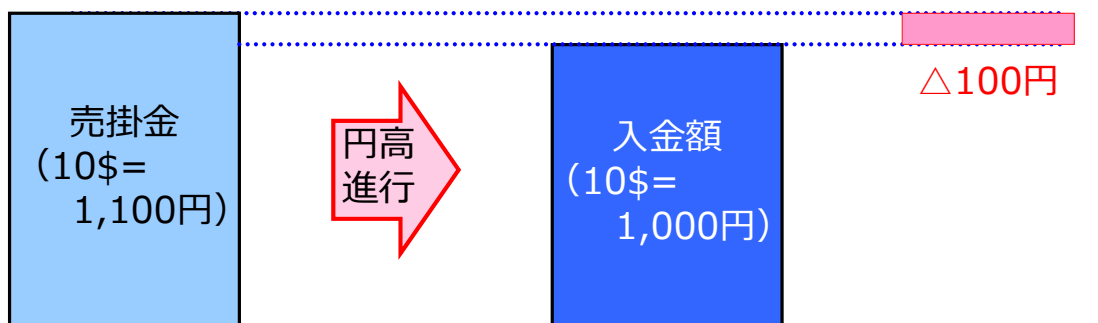
## 為替変動による影響の発生要因④

### 【ドル建売掛金入金時のレート変動による影響】

- ドル建売掛金のお入金がある場合には、円高に進行するとマイナス、円安に進行するとプラスの影響が発生する（営業外の為替差損益）
- 当社はこのリスクを限定的にするために、為替予約を行っている

① 販売時 (1\$ = 110円)

② 入金時 (1\$ = 100円)



## ■ 売上総利益への影響額

- 為替レートが円高に進行したことにより、年間ではマイナス方向に

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4
為替レートの変動（円）	113→ 106	106→ (111)→ 109	111→ 113	113→ 110	108→ 110	110→ (112)→ 107	108→ (106)→ 108	108→ (109)→ 108
為替変動の影響（売上総利益）	-148	3	52	59	-63	-124	-108	69
仕入値引債権の評価額変動の影響	-338	-8	307	341	-396	60	-542	241
調達在庫の為替レート変動の影響	189	11	-256	-280	333	-183	434	-172

## ■ 営業外損益への影響額（期末評価替の影響は含まず）

- 買掛金支払時のレート変動の影響は、売上総利益への影響と、おおよそ相殺関係となる

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4
買掛金支払時のレート変動の影響 (営業外)	88	-19	-89	-34	-15	122	64	-98

- 売掛金受取時のレート変動の影響額は、為替レートが円高に進行したことによりマイナス方向に（為替予約実施のため変動影響は縮小されている）

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4
売掛金受取時のレート変動の影響 (営業外)	-74	-25	-8	20	-42	-49	-61	-3

(百万円)	2019年12月期 実績			2020年12月期 業績予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
半導体	13,473	13,991	27,464	12,400	13,500	25,900	△1,564	△5.7%
FPGA	6,938	6,215	13,154	5,500	5,500	11,000	△2,154	△16.4%
特定用途IC	2,421	2,404	4,825	1,700	2,300	4,000	△825	△17.1%
汎用IC	1,542	1,686	3,228	1,600	1,600	3,200	△28	△0.9%
アナログ	969	1,206	2,175	1,250	1,350	2,600	424	19.5%
メモリ	1,601	2,479	4,081	2,350	2,750	5,100	1,018	25.0%
デザインサービス	867	1,350	2,218	1,300	1,550	2,850	631	28.5%
ソリューション	453	265	718	300	450	750	31	4.3%
売上高合計	14,794	15,607	30,401	14,000	15,500	29,500	△901	△3.0%
営業利益	61	352	414	50	250	300	△114	△27.6%

開示区分	内容説明
半導体事業	半導体及び関連製品の販売、技術支援
FPGA	ザイリンクス社のFPGAを中心とするソリューション
特定用途IC	特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例：通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等)
汎用IC	マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション
アナログ	アナログ半導体を中心とするソリューション
メモリ	マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション
デザインサービス事業	受託開発、ODM/EMS/OEM
ソリューション事業	最終製品レベルでのソリューション提案を実施 自社製品（ハードウェア、ソフトウェア、システム）の 開発・販売

以下の担当までお問い合わせ下さい。

### 株式会社PALTEK

柴崎 由記 (IR担当)

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

TEL : 045-477-2072

FAX : 045-477-2012

E-mail : ir@paltek.co.jp